

**苏州锴威特半导体股份有限公司董事会**  
**关于本次交易符合**  
**《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产**  
**重组的监管要求》第四条规定的说明**

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买晶艺半导体有限公司（以下简称“晶艺半导体”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶艺半导体将成为上市公司的全资子公司。

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第9号》”）第四条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《监管指引第9号》第四条的规定，具体如下：

1、本次交易的标的资产为晶艺半导体100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，本次交易尚需经公司董事会和股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司已在《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；

2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在影响本次交易标的资产权属转移及过户的实质性障碍，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；

3、本次交易完成后，晶艺半导体将成为公司的全资子公司，公司能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；

4、本次交易有利于公司增强持续盈利能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

综上，本次交易符合《监管指引第9号》第四条的规定。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年3月28日